

Instrukcja montażu wielkoformatowych płyt ceramicznych SLAB

M♦NUMENTAL

Transport płyt

Zastosowany system pakowania płyt na przeznaczonych do tego paletach (typu RACK) zapewnia sprawny proces rozładunku. Sposób wiązania SLABÓW na palecie pozwala na zdejmowanie pojedynczej sztuki bez ryzyka przewrócenia się pozostałych płyt.

Ręczny transport płyt wielkoformatowych musi być realizowany przez co najmniej dwie osoby. Zawsze należy używać odpowiedniego sprzętu do przenoszenia płyt, poczynając od momentu ich rozpakowania po montaż. Należy używać uchwytów z przyssawkami, bądź listew manipulacyjnych wyposażonych w przyssawki, aby zabezpieczyć zarówno materiał, jak i samych monterów. Wózki transportowe dedykowane do płyt wielkoformatowych są odpowiednimi do przytrzymywania płyt na placu budowy, jak również do bezpiecznego nakładania kleju na tylną stronę płyty. Przy pracach związanych z obróbką płyt należy chronić krawędzie oraz narożniki przed uszkodzeniem. W trakcie prac należy stosować rękawice ochronne.

Cięcie i obróbka płyt

Obróbki płyt SLAB należy dokonywać z użyciem profesjonalnych urządzeń, zapewniając stabilność powierzchni roboczej (np. z użyciem stołu monterskiego). W pierwszej kolejności na powierzchni płyt wyznaczamy punkty i dokonujemy cięcia, ostre krawędzie należy zeszlifować. Aby wykonać cięcie w kształcie litery L, należy wywiercić otwór (o średnicy co najmniej 6 mm) na przecięciu linii wymiarowych. Następnie z użyciem szlifierki kątowej wyposażonej w odpowiednią tarczę dokonać cięcia od krawędzi do wywierconego otworu. Wszelkie otwory wykonujemy z użyciem otwornic.

Dylatowanie powierzchni

Szczeliny dylatacyjne powinny być stosowane w miejscach występowania największych naprężeń na granicy wykorzystania materiałów o różnych parametrach (stłupach, ścianach, itd.) konstrukcji materiałowych. Umożliwiają one naturalną pracę poszczególnych materiałów, niwelując naprężenia powstające na skutek naturalnego rozszerzania się i kurczenia materiałów, z których zbudowana jest cała okładzina. Szczelina powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym, aby zapobiec wzajemnemu przesuwaniu się elementów. Należy dążyć do dylatowania powierzchni zbliżonej kształtem do kwadratu (proporcja boków max. 1:2 przy montażu na podłożu) z zastosowaniem dylatacji brzegowej - obwodowej oddzielającej poszczególne powierzchnie. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w podłożu należy przenieść na warstwę ułożonych płytek.

Klejenie

Powierzchnia podłoża, na którym montowane będą płyty musi być stabilna, równa, wolna od pęknięć, dokładnie oczyszczona, niepodatna na odkształcenia i zagruntowana, w celu wyrównania chłonności. Płytę SLAB należy montować z zastosowaniem metody kombinowanej, czyli takiej gdzie klej rozprowadza się pacą zębatą zarówno na podłożu, jak i klejoną płytkę. Kierunek rozkładu kleju na płycie i podłożu powinien być taki sam. Zalecamy stosowanie kleju klasy C2TE S1, przygotowanego według podanej instrukcji. Należy mieć na uwadze, aby finalna grubość warstwy kleju nie była większa, niż zaleca producent zaprawy. Prostoliniowe ułożenie płyt regulujemy używając uchwytów z przyssawkami. Do regulacji stosujemy kliny dystansowe. Aby zapewnić całkowite zespolenie materiałów należy płytę z naniesionym klejem równomiernie docisnąć do podłoża, a następnie zawibrować. Szerokość fugi pomiędzy płytami powinna wynosić co najmniej 2 mm (przy montażu wewnątrz pomieszczeń) i minimum 5 mm przy montażu zewnętrznym. Dodatkowo dla wyrównania powierzchni zaleca się zastosowanie systemów poziomowania. W celu dokonania prawidłowego montażu płyt można wspomagać się profesjonalnymi narzędziami, np. przyssawkami wibrującymi, przyrządami do zbliżania płyt. Nadmiar kleju należy usunąć ze szczelin spoinowych, a wszelkie zabrudzenia zmywać na bieżąco. Kliny dystansowe należy usunąć po upewnieniu się, że zaprawa klejowa uległa całkowitemu stwardnieniu.

Fugowanie

Fugowanie płyt należy rozpocząć po stwierdzeniu całkowitego ich zespolenia z podłożem z uwzględnieniem czasu na odparowanie wody zarobowej z materiału użytego do montażu. Przed przystąpieniem do fugowania należy przemyć całą powierzchnię okładziny (w przypadku stosowania spoiny epoksydowej powierzchnia musi być sucha). Przed fugowaniem całej okładziny bezwzględnie należy wykonać próbę spoinowania na niewielkim fragmencie płytki i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu określenia wpływu fugi na użyty rodzaj płytek. W przypadku stwierdzenia trudności w usunięciu pozostałości zaprawy spoinowej należy zmienić rodzaj stosowanej fugi.

Czyszczenie po montażu

Do po montażowego czyszczenia płytek zaleca się stosowanie ogólnodostępnych środków myjących, zgodnie z ich przeznaczeniem (pozostałości cementowe - środkami o odczynie kwaśnym, a pozostałości syntetyczne - środkami o odczynie zasadowym). Użycie środków myjących wymaga uwzględnienia wskazówek podanych przez producenta oraz wykonania próby na niewielkim fragmencie czyszczonej powierzchni.

Wszystkie czynności glazurnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przestrzegając zasad BHP.